

LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Инновационный разъем для быстрого соединения – простой, надежный и экономичный:

Клеммы на печатную плату с пружинным соединением и технологией прямого соединения PUSH IN. Прорыв в технологии соединений.

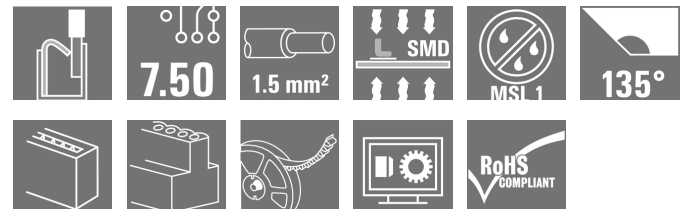
Удивительно простое и просто удивительное в практическом применении:

- Легкое соединение и отделение жестких кабелей или кабельных наконечников без использования инструментов
- Обработываются автоматически на этапе пайки оплавлением сквозных отверстий или выпара
- Потенциалы и точки зажима четко обозначены цветными кнопками

Конструкция и обработка соответствуют мировому уровню, подходит для самых разных областей применения.

Клемма для печатной платы для полностью автоматического монтажа с помощью пайки расплавлением полуды, с соединением проводов PUSH IN. Ввод провода и работа ползунка с одной стороны (TOP).

- **Одножильные & гибкие провода с наконечниками не требуют сложной установки, и они готовы к работе.**
- **При подсоединении многожильных проводов без кабельных наконечников для**



открытия точки подключения используется исполнительный элемент

- **Интуитивно понятное обращение, поскольку область ввода проводов и область ручного соединения четко разделены.**
- **Упаковка в виде ленты на бобине**
- **Направление вывода проводов: 135°**

Основные данные для заказа

| | |
|----------------------|--|
| Исполнение | Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 2, 135°, черный, PUSH IN, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape |
| Номер для заказа | 1473890000 |
| Тип | LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL |
| GTIN (EAN) | 4050118280951 |
| Кол. | 210 Шт. |
| Продуктное отношение | IEC: 800 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
| Упаковка | Tape |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 10:28:29 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|------------------|----------|-------------------|------------|
| Высота | 14,45 мм | Высота (в дюймах) | 0,569 inch |
| Высота, мин. | 14,45 мм | Глубина | 12,7 мм |
| Глубина (дюймов) | 0,5 inch | Масса нетто | 2,756 g |
| Ширина | 11,7 мм | Ширина (в дюймах) | 0,461 inch |

Температуры

| | |
|---|--------|
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|---|--------|

Упаковка

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Упаковка | Tape | Длина VPE | 40 мм |
| VPE с | 330 мм | Высота VPE | 330 мм |
| Глубина ленты (T2) | 15,7 мм | Ширина ленты (Ш) | 32 мм |
| Глубина ленты с кармашками (K0) | 15,2 мм | Высота ленты с кармашками (A0) | 11,3 мм |
| Ширина ленты с кармашками (B0) | 19,49 мм | Разделение кармашка ленты (P1) | 20 мм |
| Перфорация для разделения ленты (E) | 1,75 мм | Разделение кармашка ленты (F) | 14,2 мм |
| Диаметр катушки с лентой ϕ (A) | 330 мм | Поверхностное сопротивление | $R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$ |

Системные параметры

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Серия изделия | OMNIMATE Signal — серия LSF | Метод проводного соединения | PUSH IN |
| Монтаж на печатной плате | Соединение под пайку для поверхностного монтажа | Направление вывода кабеля | 135° |
| Шаг в мм (P) | 7,5 мм | Шаг в дюймах (P) | 0,295 inch |
| Количество полюсов | 2 | Количество полюсных рядов | 1 |
| Монтаж силами заказчика | Нет | Компланарность: | 100 μ m |
| Количество контактных штырьков на полюс | 2 | Длина зачистки изоляции | 8 мм |
| L1 в мм | 7,5 мм | L1 в дюймах | 0,295 inch |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
| Объемное сопротивление | 1,60 МОм | | |

Данные о материалах

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Изоляционный материал | LCP GF | Цветовой код | черный |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 | Группа изоляционного материала | IIIa |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 175 | Moisture Level (MSL) | 1 |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Материал контакта | Медный сплав |
| Структура слоев соединения под пайку | 4...6 μ m Sn матовый | Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Температура хранения, макс. | 70 °C | Рабочая температура, мин. | -50 °C |
| Рабочая температура, макс. | 120 °C | Температурный диапазон монтажа, мин. | -30 °C |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C | | |

Провода, подходящие для подключения

| | |
|------------------------|----------------------|
| Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm ² |
| Диапазон зажима, макс. | 1,5 mm ² |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 10:28:29 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | |
|--|----------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,2 mm ² |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U | 1,5 mm ² |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,2 mm ² |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K | 1,5 mm ² |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,25 mm ² |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 0,75 mm ² |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,25 mm ² |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 1,5 mm ² |

| Зажимаемый проводник | Сечение подсоединяемого провода | Тип | тонкожильный провод |
|----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | номин. | 0,25 mm ² |
| кабельный наконечник | | Длина снятия изоляции | номин. 10 мм |
| | | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H0.25/12 HBL |
| | | Сечение подсоединяемого провода | Тип тонкожильный провод номин. 0,34 mm ² |
| кабельный наконечник | | Длина снятия изоляции | номин. 10 мм |
| | | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H0.34/12 TK |
| | | Сечение подсоединяемого провода | Тип тонкожильный провод номин. 0,5 mm ² |
| кабельный наконечник | | Длина снятия изоляции | номин. 10 мм |
| | | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H0.5/14 OR |
| | | Сечение подсоединяемого провода | Тип тонкожильный провод номин. 0,75 mm ² |
| кабельный наконечник | | Длина снятия изоляции | номин. 10 мм |
| | | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H0.75/14T HBL |
| | | Сечение подсоединяемого провода | Тип тонкожильный провод номин. 1,5 mm ² |
| кабельный наконечник | | Длина снятия изоляции | номин. 7 мм |
| | | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H1.5/7 |

Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Технические данные


Номинальные характеристики по IEC

| | | | |
|---|------------------------|---|-------------------|
| пройдены испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 12 A |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 12 A | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 12 A |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 12 A | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2 | 800 V |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 630 V | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 500 V |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2 | 6 kV | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 6 kV |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 6 kV | Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 80 A |

Номинальные характеристики по CSA

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Институт (CSA) |  | Сертификат № (CSA) | 200039-1664286 |
| Номинальное напряжение (группа использования В/CSA) | 300 V | Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V |
| Номинальный ток (группа использования В/CSA) | 10 A | Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 10 A |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. | | |

Номинальные характеристики по UL 1059

| | | | |
|---|---|---|--------|
| Институт (cURus) |  | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059) | 300 V | Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
| Номинальный ток (группа использования В/UL 1059) | 12 A | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. | | |

LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002643 | ETIM 7.0 | EC002643 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |

Важное примечание

| | |
|------------------|--|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
| Примечания | <ul style="list-style-type: none"> • Дополнительные цвета кнопки по запросу • Рабочее усилие скользящего контакта макс. 40 Н • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4 • Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1 • Р на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • Обжим формы «А» обжимных втулок для фиксации концов проводов рекомендуется выполнять обжимным инструментом PZ 6/5. • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °С и средней влажности 70%, 36 месяцев |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | E60693 |

Загрузки

| | |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Declaration of the Manufacturer |
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD |

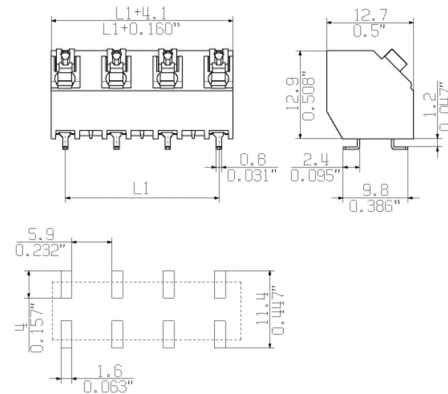
LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

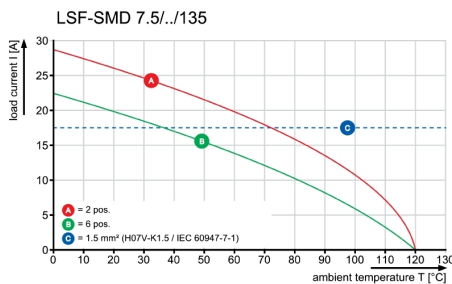
www.weidmueller.com

Изображения

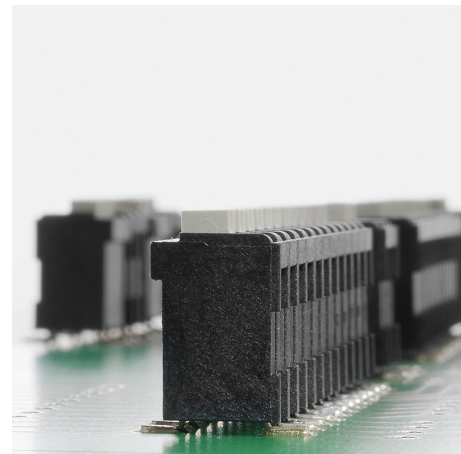
Dimensional drawing



Graph

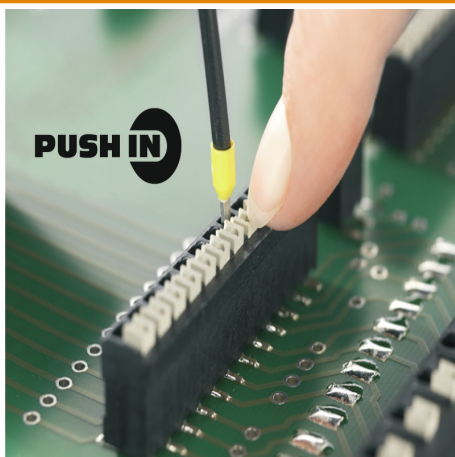


Преимущество изделия



Stable solder connection

Преимущество изделия



PUSH IN wire connection

Преимущество изделия



Packaged in tape-on-reel

Изображения

Dimensional drawing



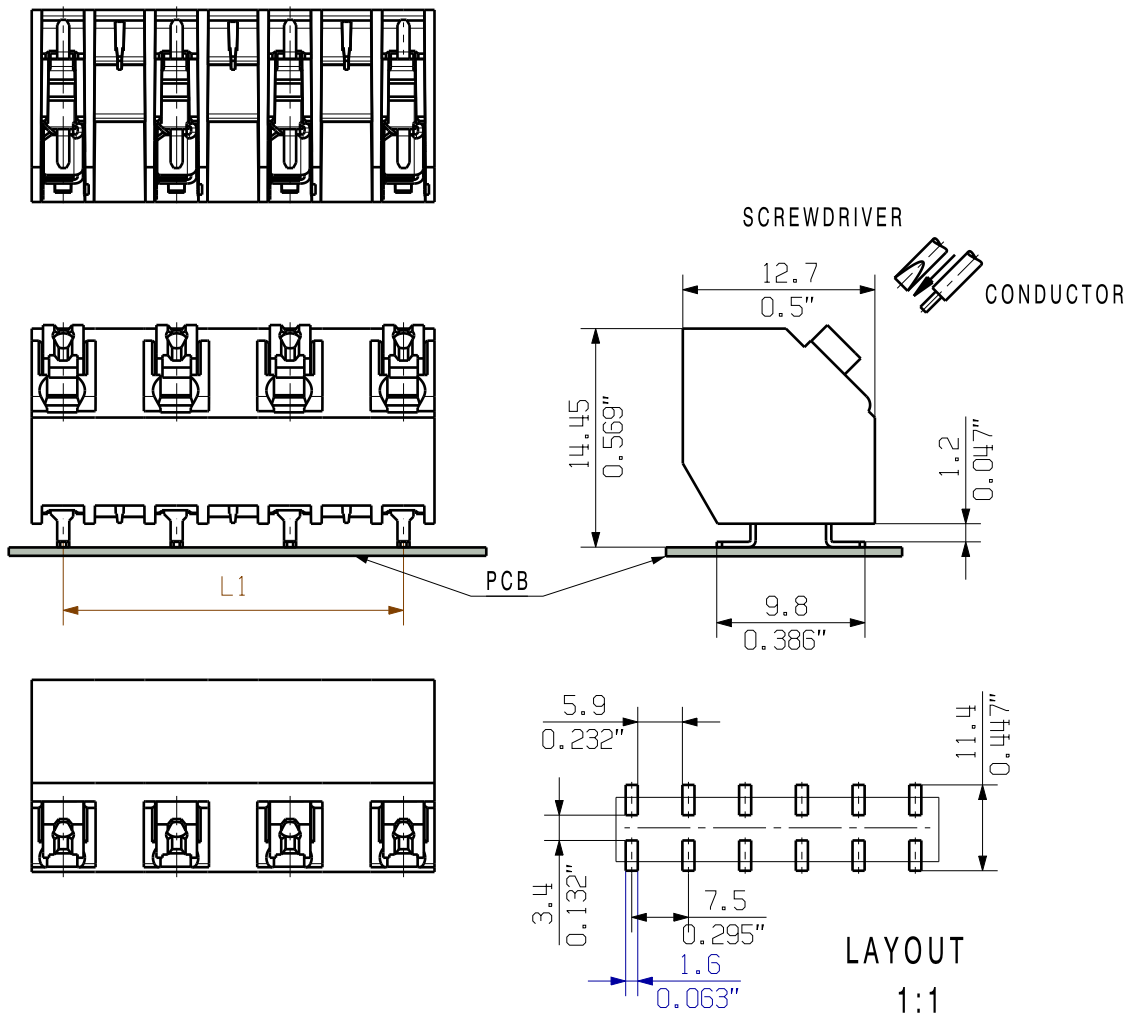
Dimensional drawing



DIRECTION OF UNREELING 

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING



For the mounting on PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.

The necessary creepage and clearance paths must be observed in the relevant equipment standards in accordance with IEC 664 / VDE 0110.

The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3.

Weidmüller PCB components are rated in accordance with the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. If the components are used in accordance with the intended purpose, the components will meet all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress.

SHOWN: LSF-SMD 7.50/04/135...

| n | L1 [mm] | L1 [Inch] |
|---|---------|-----------|
| 6 | 37,5 | 1,476 |
| 5 | 30,0 | 1,181 |
| 4 | 22,5 | 0,886 |
| 3 | 15,0 | 0,591 |
| 2 | 7,5 | 0,295 |
| n | L1 [mm] | L1 [Inch] |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | 78009/5 09.09.14 HELIS_MA 00 | | CAT.NO.: | | |
| | DIN ISO 2768-m | | Weidmüller | | |
| MODIFICATION | | C 58004 00 | | DRAWING NO. | |
| DATE | | NAME | | SHEET 01 OF 02 SHEETS | |
| DRAWN | | 11.02.2014 | | LSF-SMD 7.50/./135... | |
| RESPONSIBLE | | KRUG_M | | LEITERPLATTENKLEMME | |
| CHECKED | | 30.09.2014 | | PCB TERMINAL | |
| APPROVED | | LANG_T | | PRODUCT FILE: LSF-SMD 3.50 | |
| SCALE: 2:1 | | PRODUCT FILE: LSF-SMD 3.50 | | 7358 | |
| SUPERSEDES: | | PRODUCT FILE: LSF-SMD 3.50 | | 7358 | |

WEITERGABE SOWIE Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdruuecklich gestattet.
 ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
 THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
 OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
 © WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.